

濮阳惠成电子材料股份有限公司
全体董事及高级管理人员
关于切实履行填补回报措施之承诺函

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票。为进一步保护公司上市后投资者的权益，本人作为濮阳惠成董事/高级管理人员，现根据中国证监会于 2015 年 12 月 30 日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定要求，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩（如有）。

（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对本人具有法律约束力，如违

反本承诺，给公司或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。

特此承诺！

（以下无正文）

（本页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司全体董事及高级管理人员关于切实履行填补回报措施之承诺函》之签署页）

全体董事签名：

王中锋

杨瑞娜

常庆彬

于洪辉

胡卫升

任保增

李曙衢

高级管理人员签名

王中锋

常庆彬

陈淑敏

王国庆

2016 年 9 月 28 日